

應用 →

EMI 防磁保護

Schlenk 產品：**ETP銅箔，
光面，表面鍍錫或鍍銀**

可防護電磁干擾（EMI/RFI）。例如，防護電視臺或無線電臺。也可用於防護私家電子設備。銅箔主要在光面條件下使用，有時鍍錫，有時鍍銀，也可作板材使用。層壓由我們客戶處理。當產品用於不利的環境或用於高質量應用時，有時需要鍍錫或鍍銀，以避免發生氧化。當使用於軍用規格的防護應用時，則需要鍍銀。

標準規格：**基礎材料：****ETP銅箔 E-Cu58 (BS: C101)****額外的表面強化處理（如果要求）
鍍錫 或 鍍銀****帶材厚度： 0.010 毫米 - 0.200 毫米****寬 度： 1.0 毫米 - 650 毫米（具體取決於厚度和表面）**

規格：可以提供 卷材形式 或 切割成片，未壓平形式。



每捲大小設計：

ID.: 150 mm 塑膠內芯

ID.: 76 mm 鐵心

其他內芯-ID：（可依據要求）

Schlenk 箔的優點：

- 高純度紅銅
- 高導電性確保高的防護效果
- 比多數競爭者的寬度寬

批量大小

我們提供研發和設計用的小批量，快速而具有靈活性，以及可完成集裝箱裝載的大批量。

我們相信以上本文檔中所含資訊是可靠的，但我們並不保證其精確性和完整性。用戶應根據應用的目的確定產品的適用性。

Schlenk Metallfolien GmbH & Co. KG
Barnsdorfer Hauptstrasse 5
D-91 154 Roth
Germany

電話：+ 49 -(0) 9171– 8080
傳真：+ 49 -(0) 9171 - 808 200
電子郵箱：foils@schlenk.de
網站：<http://www.schlenk.de>